

NUMBER 178328

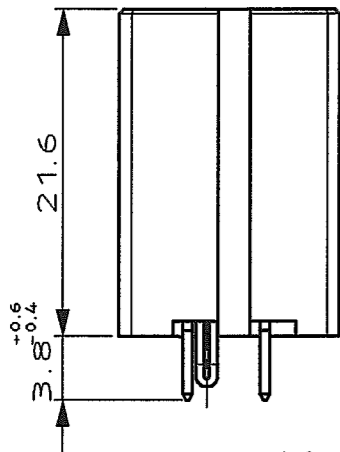
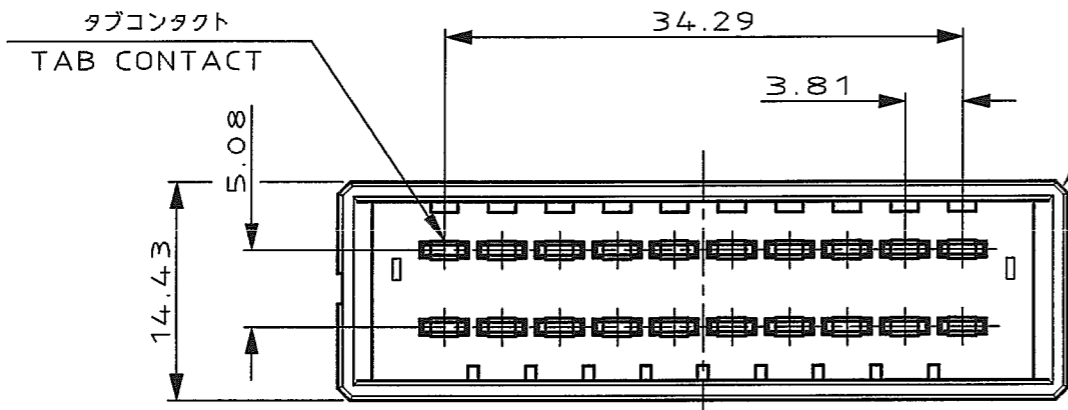


3rd ANGLE PROJECTION

METRIC

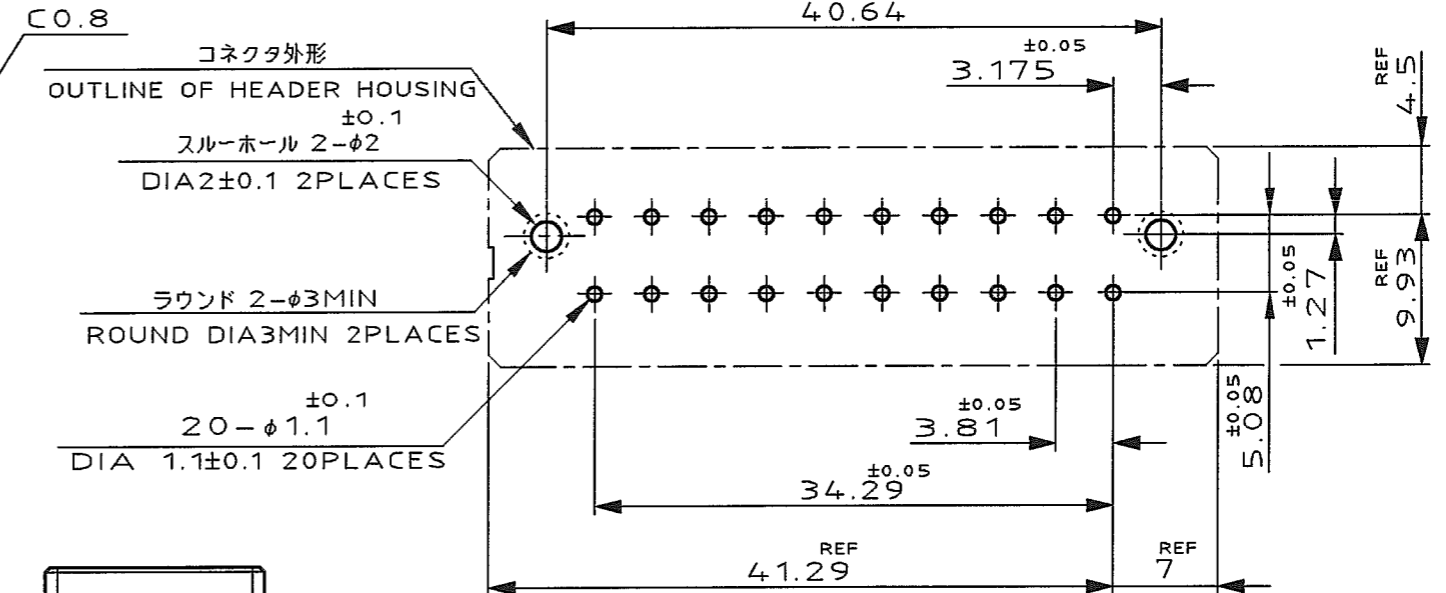
DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



- 回路番号
CIRCUIT NO
- リテンションレグ
RETENTION LEG
- コンタクト半田付部
CONTACT TAIL

△6	△4	178328-5
△6	△3	178328-3
△6	△2	178328-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)



推奨基板取付け寸法

PC 基板厚: 1.6 ± 0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- △2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- △3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- △4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- △5. FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- △6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 色: 黒色
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- △2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN金めっき
- △3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN金めっき
- △4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- △5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
- △6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

D1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME				
mm²(AWG -)		mmφ		20POS DOUBLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3100				
MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		SIZE	LOC	NUMBER
DR. 20-JAN-'93 Y. TANAKA		DE. 20-JAN-'93 Y. TANAKA		10MF : ±0.3 100MF 30MF : ±0.4 300MF 1000MF : ±0.5 角度 : ±3'		A3	J	C-178328
CHK. 8-FEB-'93 S. MANABE		APP. 8-FEB-'93 S. MANABE		SCALE		REV.	SHEET	
				2-1		D1	1 OF 1	



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[178328-2](#)